Es gibt Neues!

ANDANTA

Lineare InGaAs-Sensoren

512 Pixel
25 x 250 µm Rechteck-Pixel für Spektroskopie
0.9 - 1.7 µm
ca. 40 kHz Ausleserate (t.b.d.)
28-pin DIP-Metallgehäuse mit 1-stufigem Thermokühler

1024 Pixel
12.5 µm quadratische Pixel
0.9 - 1.7 µm
ca. 40 kHz Ausleserate (t.b.d.)
28-pin DIP-Metallgehäuse mit 1-stufigem Thermokühler

In das Infrarot erweiterte 1.9 µm-InGaAs-Matrizen

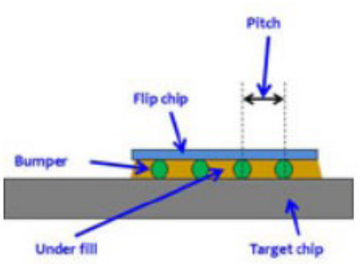
QVGA (320 x 256) + VGA (640 x 512)-Pixelauflösung

Kompaktes 2-stufig gekühltes 50 mm-Gehäuse mit reduzierter Leistungsaufnahme

SWAP – Small Weight and Power

Niedrigeres Rauschen und weniger Kreuzschraffur-Effekte als 2.2 µm-InGaAs

Flip-Chip-Bondservice



Bonden von Flip-Chip auf Target-Chip mit Indium-Perlen

Zur Herstellung von FPAs, LDAs, MEMS, BGAs. 3D-ICs, µLEDs

VISION

Besuchen Sie uns auf der Vision 2022

Stuttgart Messe, 04. - 06. Oktober 2022
Halle 10, Stand 10H51

ANDANTA GmbH Detektortechnologie
Tel: +49 (0)8142 41058-0 | Mobil: +49 (0)171 1200051 | Fax: +49 (0)8142 41058-29
E-Mail: epost@andanta.de | Internet: www.andanta.de
Ilzweg 7+9 | 82140 Olching | Deutschland